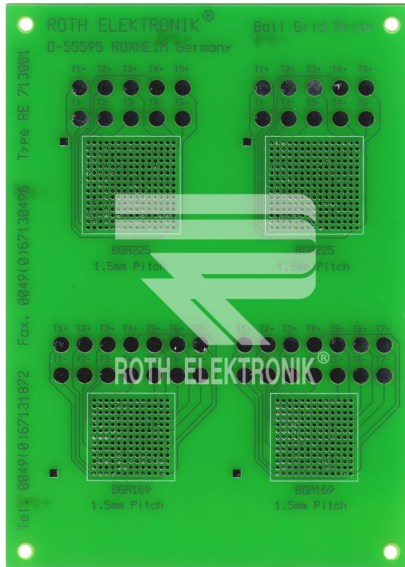


Placa de circuito impreso para ejercicios de soldadura (pick and place) para BGA



RE713001-LF



- epóxido FR4 1,50 mm, por un lado 35 µm CU
- lado de soldadura estañado en caliente (HAL-leadfree), máscara de inhibición de soldadura e impresión de dotación
- placa de circuito impreso para ejercicios de soldadura "pick and place" para BGA 169 y 225 trama 1,50 mm incl. puntos de test "daisy chain"
- introducción en la tecnología vanguardista BGA

BGA 169: 2x
BGA 225: 2 x

- tamaño: 100 x 140 mm